

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 2023 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

##### （二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-12,000万元到-17,000万元。

（2）经财务部门初步测算，预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-17,000万元到-23,000万元。

##### （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

2022年年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为7,691.21万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为900.92万元。

#### 三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因如下：

1、受半导体行业周期波动的影响，公司2023年的IP授权收入同比下降；受行业芯片去库存和市场竞争导致芯片产品价格调整下降等因素影响，公司报告期内自主芯片与模组业务销售收入和毛利率同比下降；前述两项影响当期业绩。

2、受部分产品生产时间周期加长的影响，公司在手订单中两个定制服务的项目未能按预期实现客户产品和服务交付，公司报告期内定制服务收入和去年业绩基本相当，未能实现预期增长。但由于定制芯片设计服务项目人力成本占比上

升、基于先进工艺的定制芯片量产服务芯片销售价格下降和晶圆价格上升等原因，定制服务毛利率同比下降，影响当期业绩。上述两个定制服务项目正在继续加紧实施中。

3、公司报告期内加大了对汽车电子芯片、面向服务器的高可靠存储管理控制芯片（Raid芯片）的研发投入和市场团队建设，导致公司研发费用、销售费用和管理费用有较大幅度增加，影响当期业绩。

4、公司报告期内投资收益、营业外收入等非经常性损益同比下降，影响当期业绩。

公司2023年年底在手订单同比较大幅度增长，与2023年6月底相比继续增长。得益于研发投入的增加、研发人员的增多以及公司市场团队的扩展，公司于2023年新推出的系列化汽车电子芯片及服务器高可靠存储管理控制芯片（Raid芯片）均已进入诸多客户的测试开发和应用阶段，部分产品亦已获得客户订单，未来公司盈利能力有望获得提升。

#### **四、风险提示**

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

#### **五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日